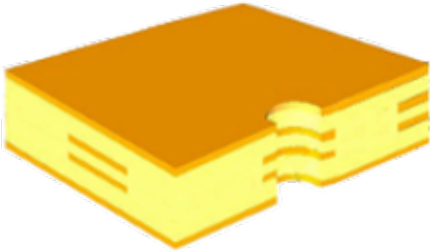


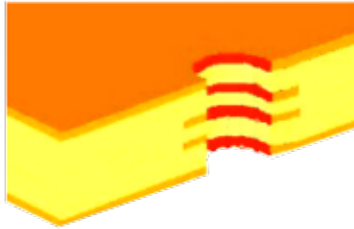
Perforado

Los paneles son perforados lado a lado en donde van las vías.



Desmear

Para conseguir buen contacto entre layers y la vía se realiza una limpieza del agujero dejando libre de impurezas al cobre.



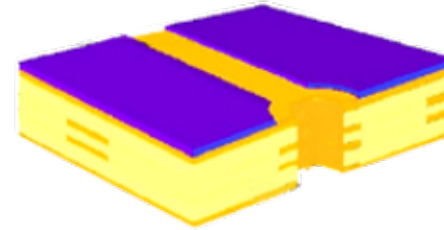
Metalizado

En una serie de cubas con diversas soluciones se aplica el proceso electrolítico para metalizar la vía.



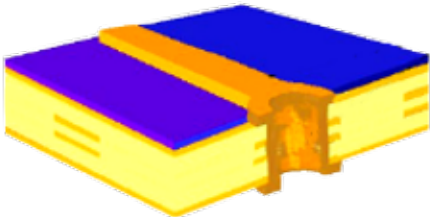
Imagen

Se transfiere la imagen revelada en laboratorio con el negativo del circuito a grabar.



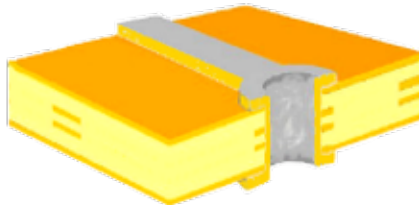
Engrosamiento

Se realiza una deposición de cobre mediante electrolisis sobre la superficie sin fotopolímero.



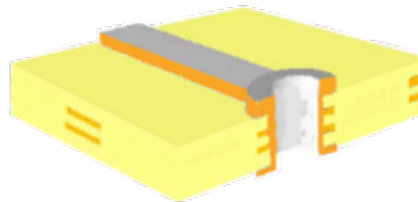
Estañado

Se realiza otra capa pero de estaño para proteger el grabado.



Grabado

Consiste en grabar el cobre no protegido por el estaño, colocándolo en una cuba con ácidos que atacan al fotopolímero.



Revelado

Por último se quita el ataque ácido al cobre no estañado dejando así solo las pistas del circuito impresas y las vías.

